

Si Integrated Heat Spreaders for fcCSP Packages

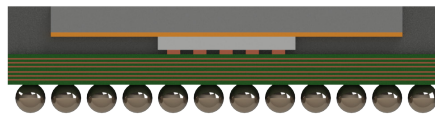
Si는 히트스프레더의 소재로 Cu를 대체하는 효과적인 재료입니다.

- ▶ 우수한 열전도율과 프로세스의 용이성을 내세운 Si는 Cu를 대체할 수 있는 히트스프레더 자재입니다.
- ▶ Si Integrated Heat Spreader (IHS)는 상부 면적을 방열판에 노출하는 동시에 몰드에 임베디드될 수 있습니다.

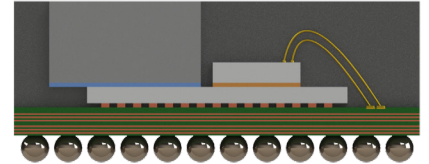
Si HIS의 사용 예 :

Si Integrated Heat Spreader Considerations

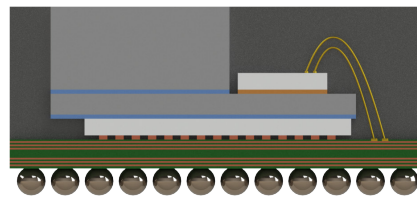
앰코의 패키지 향상 솔루션은 Si 표면을 방열판에 노출시킨 상태에서 몰드 내부에 임베디드할 수 있습니다.



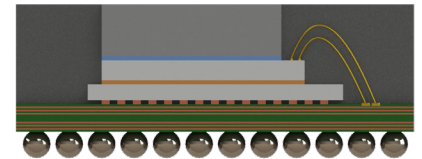
단일 칩 fcDSP에 포함된 상면을 노출한 Si IHS



병렬 하이브리드 구조에 포함된 상면을 노출한 Si IHS












하이브리드 구조의 듀얼 Si IHS



스택 하이브리드 구조에 포함된 상면을 노출한 Si IHS

범례

	Si Integrated Heat Spreader (IHS)		플립 칩 범프
	Thermal Interface Material (TIM)		와이어본드 핑거
	활성 Si (플립 칩 또는 와이어본드)		기판
	와이어본드 칩 어태치 재료		솔더 볼
			와이어본드

자세한 내용은 amkor.com을 방문하거나 ATKQnA@amkor.co.kr로 이메일을 보내십시오.



본 문서의 모든 콘텐츠는 저작권법에 따라 무단복제 및 배포를 금지하며, 제공된 정보의 정확성을 보장하지는 않습니다. 앰코는 본 문서의 정보사용에 따른 특허나 라이선스 등과 관련된 어떠한 형태의 피해에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 본 문서는 앰코의 제품보증과 관련하여 표준판매약관에 명시된 것 이상으로 확대하거나 변경하지 않습니다. 앰코는 사전고지 없이 수시로 제품 및 제품정보를 변경할 수 있습니다. 앰코의 이름 및 로고는 Amkor Technology, Inc.의 등록상표입니다. 그 외 언급된 모든 상표는 각 해당 회사의 자산입니다.
© 2019 Amkor Technology Incorporated. All Rights Reserved. TS115B 04/19